MicroAssembly Technologies, Ltd.

MODEL 6495/6/7 DIE ATTACH SYSTEM
芯片贴装系统

适用于 MCM、厚膜电路、银浆基板、倒焊片以及共晶化合物等的芯片贴装系统。

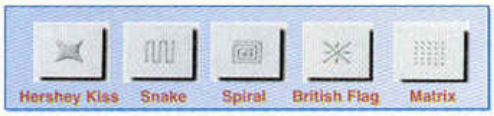
多功能的台式设备
菜单操作—友好的用户界面。

全部编程控制的生产过程
例如：速度、时间、材料的涂覆，粘片及拾片压力，焊线厚度，等等。

灵活方便的操作过程
更换品种非常方便，数分钟就能完成。高精度、高效率，特别适用于实验室及中小批量的生产过程。

适用于胶水和助焊剂的涂布
单点/多点和不同的形状

具有针式转移法的功能
根据库中预先设置的参数进行。



可编程焊线厚度控制

晶片定位或标记识别功能
拾片从晶圆最大可达 8。
(可自动或手动)

晶片或兰膜尺寸则为 2“或 4”。
也可用于形状不规则的芯片。
采用独特的传感系统（CCD 等）。

采用先进的视觉和图形识别系统
通过增加电动拾片和料架选件即可升级为全自动系统。
可在常温下和加热情况下对硅片、玻璃基板、BGA、框架、PCB 以及其它基板进行操作。

技术参数

工作范围：12“x 12”
芯片尺寸：Min 0.010“- 1”以上
芯片材料：GaAs(砷化镓)、硅、玻璃、金属等
拾片/粘片力：20 – 3000 grams.
贴片精度：25μm @ 3σ.
生产量：Max. 600 CPH.
可放最多 211 种元件在一个器件上。

MicroAssembly Technologies, Ltd.

MODEL 6900 AUTOMATIC MCM/FLIP CHIP DIE ATTACH SYSTEM
自动 MCM/倒焊片贴装系统

适用于 MCM/混合电路，银基板，倒焊片等的高效率贴装系统。

双贴片头结构

保证具有最大的灵活性。操作编程简单

机身细小

兼并两种功能

容易操作及调校

基于采用 X Windows 作界面

可以单机生产（**料管→料管**），也可**在线**连机生产

单点或多点以及多种图形涂覆方式。对于复杂的图形可以通过图形库“示教”学习

可编程**焊线厚度控制**

可处理 **70 种**不同封装的晶片/兰膜，最多达 **40 种卷带式供料架或两个 8”晶圆**

具有**晶片定位**或**标记点**识别功能

对于有源/无源元件和基板，采用先进的视觉和圆形识别系统

具有全程处理 Flip Chip 的能力　包括裸芯片拾取（从晶圆兰膜包装的晶片或编带），翻转裸芯片以及连接点助焊剂的涂覆等等。

可**同时处理** MCM 和 Flip Chip，　**自动更换**有关工具

可在常温或加热状态下工作

适用基板范围广，包括：硅板、玻璃板、BGA、框架、PCB

技术参数

工作范围：26 “ x 19
芯片尺寸：Min 0.010“ - 1”以上
芯片材料：GaAs(砷化镓)、硅、玻璃、金属等
拾片/粘片力：50 – 3000 grams.
贴片精度：20μm @ 3σ.
生产量：Max. 3000 CPH.
可通过区域网进行通讯
外形尺寸：48 “W×36” D×73” H